InProSA

Im geplanten Projekt soll die Eigenentwicklung sowie -fertigung von Mulitchip-Packages bei Rohde und Schwarz vorangetrieben werden. Neben der Substratfertigung an sich, soll auch die Montage der Packages sowie deren Bestückung auf Leiterplatten analysiert werden. Des Weiteren wird die Miniaturisierung von Hochfrequenzstrukturen durch innovative Nutzung der Leiterplatteninnenlagen erforscht. Außerdem sollen die Möglichkeiten des (Metall-)3D-Drucks in Bezug auf kleine HF-Strukturen und deren Anbindung an klassische Leiterplatten ermittelt werden. Übergreifend wird die Digitalisierung der Leiterplattenfertigung mittels AutoML weiterentwickelt und an konkreten Anwendungen umgesetzt.

Eckdaten

Laufzeit

15.02.2025 - 14.05.2028

Fördergeber

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

Projektträger

VDI/VDE Innovation + Technik GmbH

Gefördert durch
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

ROHDE&SCHWARZ